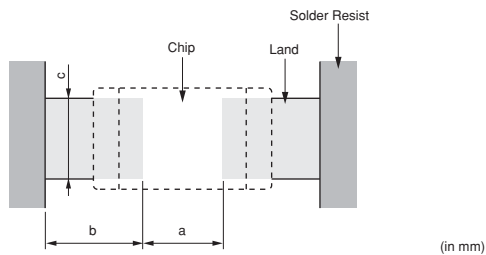


■標準ランド寸法図



Part Number	Soldering Methods	Dimensions (mm)			
		Chip (L×W)	a	b	c
PRG21	Reflow Soldering	2.0×1.25	1.0-1.2	0.5-0.7	1.0-1.2

■使用上の注意（実装上の注意）

1. 使用はんだおよびフラックス

(1) はんだ

塩素含有率0.2wt%以下のクリームはんだをご使用ください。
弊社評価用として、下記のはんだを使用しています。

- ・日本アルファメタルズ製
63Sn/37Pb RMA9086 90-3-M18
- ・千住金属工業製
96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu M705-GRN360-K2-V

(2) フラックス

はんだフラックスはロジン系をご使用ください。
以下のフラックスは性能、信頼性の劣化が考えられますので、
お避けくださるようお願いいたします。

- ・酸性の強いものおよび塩素含有率0.2wt%を越えるもの
- ・水溶性のフラックス
（*水溶性フラックスとは非ロジン系フラックスを指し、
洗浄タイプ、非洗浄タイプの双方を含みます。）

2. 洗浄条件および乾燥

はんだ付け後のフラックス洗浄については、素子の特性劣化
や電極変質の恐れがありますので、次の事項に注意してくだ
さい。

(1) 洗浄条件

洗浄液	浸漬洗浄	超音波洗浄
2-プロパノール	5分以内（常温）	1分以内
	または 2分以内（40℃以下）	20W/L以下 10～100kHz

洗浄は十分に行いフラックスは完全に除去してください。

(2) 乾燥

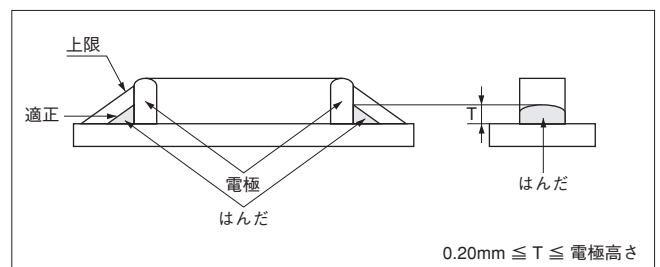
洗浄後は直ちに当製品を確実に乾燥させてください。

3. はんだ付け条件

素子破壊や特性劣化の恐れがあり、また、実装不良の原因と
もなり得ますので、基板への取り付けに際して次の事項に注
意してください。また、当製品はリフローはんだ付け対応品
になっています。フロー方法によるはんだ付けは行わないで
ください。

(1) クリームはんだ印刷

- ①標準クリームはんだ塗布厚み：150～200 μ m。
- ②はんだ盛り量は、過多にならないよう確実にはんだを付
着させてください。右記に示すフィレット高さを良品と
して判断しています。
- ③はんだ盛り量が多い程、チップ部品が受ける機械的スト
レスは大きくなり、はんだ盛り量が過剰な場合、クラッ
クや特性不良の原因となります。
標準クリームはんだ塗布厚みでご利用ください。



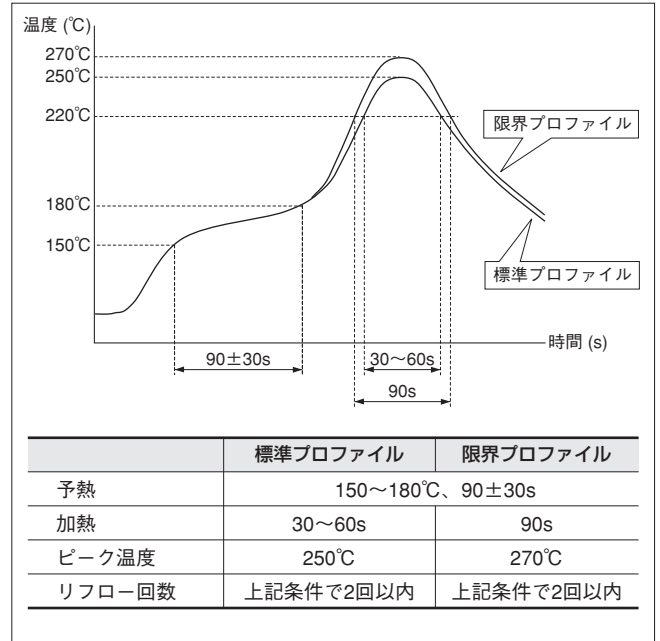
次ページに続く

前ページより続く

(2) リフローはんだ付け条件

右記の温度プロファイルでのリフローはんだ付けを推奨します。

- ① 予熱が不十分ですと、素子にクラックが入る場合があります。なお、予熱温度とピーク温度の差は100℃以内になるようにしてください。
- ② はんだ付け温度が不十分ですと、素子へのはんだ濡れ不足が発生する場合があります。ピーク温度は、240～270℃の範囲内になるよう行ってください。
- ③ はんだ付け後、溶剤などへの浸漬により急冷しないでください。
- ④ 上記の推奨はんだ付け条件以外で実装される場合は、貴社実装条件下での実装状態の評価を必ず行ってください。



- (3) 実装における諸条件によっては、予測できない実装状態が発生する恐れがありますので、貴社実装条件下での、実装状態のご確認を必ず行ってください。